

Interflux® DP 5505IC ist eine no-clean bleifreie Lotpaste mit hoher Stabilität und geringer Voidbildung.



Hohe Stabilität auf der Schablone



Geringe Lunkerbildung (Voiding)



Perfekt für die Dampfphase so wie normales Reflow



Absolut halogenfrei



Gleichmäßiger Rückstand, verbesserte Reinigbarkeit



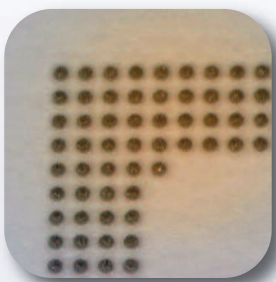
Braucht keine Sicherheitsetikettierung



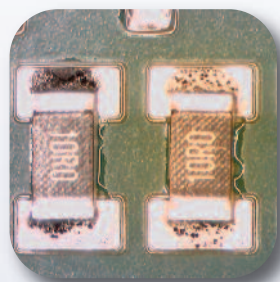
Die DP 5505IC ist eine optimierte Version von der DP 5505. Die Chemie ist entwickelt worden um Lunkerbildung zu reduzieren, um sauber zu löten in der Dampfphase und um die Reinigbarkeit der Rückstände nach Reflow zu verbessern.

Die Paste behält ihre hohe Stabilität auf der Schablone in Kombination mit absoluter Halogenfreiheit.

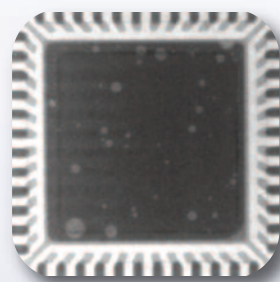
Zusätzlich braucht die DP 5505IC keine Sicherheitsetikettierung (GHS) mehr und ist sie interessant im Preis.



Scharfes Druckbild
µBGA



Lötergebnis
Dampfphase



Voiding bei QFN
Kapazität



Kein Sicherheits-
piktogramm



Bleifreie Legierungen



Typ 3 und Typ 4 (Typ 5 für bestimmte Legierungen)



Dosen, Kartuschen und Spritzen

